

H700-Soft 超软系列

【导热硅胶垫片】规格书



- 产品图 -

应用特点:

- 低压力应用、可压缩性好
- 无回弹应力或低回弹应力
- 低热阻
- 良好的界面接触
- 良好的绝缘性、耐高压击穿

应用领域推荐:

- 芯片与散热模块之间
- 光电行业
- 网通产品
- 家电行业
- 可穿戴设备
- 装配压力敏感环境

该系列产品环保符合RoHS2.0、卤素、REACH标准。

运输过程及产品室温储存条件: 阴暗处储存

储存温度: $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$

储存湿度: 40%~70%

堆放高度不超过7层, 而且总高度不超过1M

保质期:

在储存条件下: 2年

不符合储存条件下: 6个月

注意事项:

使用时戴好手套, 避免粘性面与手上的汗液接触, 使粘性面粘性减少; 且轻拿轻放, 避免损坏产品表面。

鸿富诚 H700-Soft 系列导热硅胶垫片, 是一种超软、高导热、低热阻的单面粘性的导热界面材料。产品具有较好的应力应变性, 超低的安装应力, 可避免安装应力对芯片、PCB等零部件的损坏, 适用于对安装要求严格的场合。产品自然粘性和高压缩性, 能够较好地填充间隙, 实现发热部件到散热部件之间的热传递。产品极具工艺性和使用性, 是一种极佳的导热填充材料, 被广泛应用于电子电器产品中。

产品性能

NO.	参数	单位	测试方法
颜色	灰色	---	目视
厚度	1~4	mm	ASTM D 374
硬度	40(± 5)	Shore 00	ASTM D 2240
密度	3.25(± 0.2)	g/cc	ASTM D 792
拉伸强度	≥ 0.05	Mpa	ASTM D 412
延伸率	≥ 40	%	ASTM D 412
压缩比	≥ 50 (@50Psi)	%	ASTM D 575
阻燃等级	V-0	---	UL-94
使用温度	-50~180	$^{\circ}\text{C}$	IEC 60068-2-14

热学特性

导热系数	7.0(± 0.7)	W/m \cdot K	ASTM D 5470
@15Psi/2mm	0.28	$^{\circ}\text{Cin}^2/\text{W}$	ASTM D 5470
@30Psi/2mm	0.22	$^{\circ}\text{Cin}^2/\text{W}$	ASTM D 5470
@50Psi/2mm	0.15	$^{\circ}\text{Cin}^2/\text{W}$	ASTM D 5470

电学特性

击穿电压	≥ 8	KV/mm	ASTM D 149
体积电阻率	$\geq 10^{10}$	$\Omega \cdot \text{cm}$	ASTM D 257

以上数据由鸿富诚实验室提供, 该实验室保留最终解释权

不同压缩比状态下的应力特性

